

电容器

TDK 推出 EIA 2220 尺寸的紧凑型 CeraLink® 电容器

2022 年 3 月 16 日

TDK 集团（东京证券交易所代码：6762）扩展了其成熟的 CeraLink® 系列电容器产品组合范围，使其覆盖到小型尺寸。在此之前，该产品组合仅包含即装即用的大尺寸型号。为拓展其应用范围，我们推出了采用经典片式设计的小尺寸型号。新系列元件的封装尺寸小至 EIA 2220，仅为 5.7 x 5 x 1.4 mm。其中订购代码为 B58043* 的型号的工作电压为 500V，电容为 250 nF。新元件当前有标准和软端子两种封装方式，预计未来将增加更多尺寸和电压等级选项。

新元件允许的工作温度范围为 -40 °C 至 +150 °C，其独特亮点之一是具有超低寄生系数：在室温和 1 MHz 条件下，等效串联电阻 (ESR) 仅为 40 mΩ，等效串联电感 (ESL) 为 3 nH；并且较高温度条件下的 ESR 和 ESL 值甚至更低。凭借该特性，新元件在 200 kHz 和 25 °C 环境温度条件下可实现高达 9 A_{RMS} 的大电流能力。

新系列元件的典型应用包括用作吸收电容器或输出滤波电容器。其中尺寸紧凑的 CeraLink SMD 版本能更靠近快速开断功率半导体（比如 IGBT 模块，以及 SiC 基或 GaN 基半导体）安装，并且其低 ESL 值特性可实现超低的引线电感。

CeraLink 系列电容器基于掺镧锆钛酸铅 (PLZT) 陶瓷技术。相比于传统的陶瓷电容器，它们能在工作电压下提供最大容量，甚至会随着纹波电压比例的增加而增加。关于此类反铁电电容器的特殊性能，请参见相关技术指南。

主要应用

- 快速开断功率半导体的吸收电容器
- 输出滤波电容器

主要特点和优势

- 紧凑尺寸：仅 5.7 x 5 x 1.4 mm (EIA 2220)
- 低等效串联电阻 (ESR)：室温条件下仅为 40 mΩ
- 低等效串联电感 (ESL)：仅 3 nH
- 大电流能力：高达 9 A_{RMS}@200 kHz, 25 °C

关于 TDK 公司

TDK 株式会社总部位于日本东京，是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK 建立在精通材料科学的基础上，始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技，吸引未来”，迎接社会的变革。公司成立于 1935 年，主营铁氧体，是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 全面和创新驱动的产品组合包括无源元件，如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、

磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统（如：温度和压力、磁性和 MEMS 传感器）。此外，TDK 还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括 TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics 以及 TDK-Lambda。TDK 重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在 2021 财年，TDK 的销售总额为 133 亿美元，全球雇员约为 129,000 人。

如需下载本文和相关图片，请访问 www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/220316。

如需了解该产品的更多信息，请访问 www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/ceralink。

如有疑问，请将邮件发送至 marketing.communications@tdk.com。

地区媒体联系方式

区域	联系人	公司	电话	电邮
大中华	孙婉文	香港东电化电子有限公司 香港/中国	+852 3669-8224	stella.suen@tdk.com